

- ワークショップの醍醐味である異分野、競合を超えた技術者間の交流の場を重視。業界の著名な先生方をナイトセッション講師として実装業界の将来像を語って頂きます。各講師毎グループを作って討議。事前希望で振分。

**\* ナイトセッション(1日目) 「日本実装業界の将来像」**

講師5名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。事前希望でグループ分け。

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| A. 泉谷 渉 氏 産業タイムズ社<br>代表取締役  | 「品質・機能の時代が到来<br>～その主役は考えて考えて戦い抜くニッポン」   |
| B. 須賀唯知 氏 東京大学 教授           | 「インターコネクション技術の現状と常温接合の将来性」              |
| C. 田畑 修 氏 京都大学 教授           | 「MEMS ビジネス活性化戦略」                        |
| D. 近藤和夫 氏 大阪府立大学 教授         | 「実用化する三次元実装」                            |
| E. 畑田賢造 氏 アトムクス研究所<br>代表取締役 | 「会社にしがみつこうか、会社を造ろうか、<br>それともフリータになろうか？」 |

**\* 講演会(2日目)**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 須賀唯知 氏 東京大学 教授          | 「3D 集積化のための低温接合」                              |
| 泉谷 渉 氏 産業タイムズ社<br>代表取締役 | 「近未来の実装技術はニッポンが切り開く<br>～IT・医療・環境の新分野に多角展開しよう」 |

**\* ポスターセッション(2日目) 30件**

**パワーエレクトロニクス**

- 「自動車におけるアクチュエーター体化製品の实装技術」
- 「酸化銅粒子を用いた高温環境向け接合技術の開発」
- 「高熱伝導性高分子材料の作成とその熱伝導特性の評価」

**3D インテグレーション**

- 「3次元積層によるローリングシャッタ歪なしイメージセンサ」
- 「三次元 LSI 積層実装に対応する部品内蔵インターポーザの電源インパダンス評価」
- 「3D-IC用層間充填材の開発」

**部品内蔵基板**

- 「スマホ向け部品内蔵技術」
- 「熱可塑樹脂PALAPを用いた部品内蔵技術」
- 「部品内蔵と評価・シミュレーション技術、最新動向と課題」

**インターコネクション**

- 「表面平坦化によるウエハ常温接合」
- 「表面活性化によるハンダパンプの固相拡散低温接合」
- 「Cu 被覆 Zn/Al クラッドはんだ」

**MEMS**

- 「2軸フローセンサーによる気流の見える化」
- 「近赤外に依る MEMS 内部検査」
- 「ナノインプリントによる高輝度LED用PSS基板製造プロセス」

**プリントエレクトロニクス**

- 「室温で焼成可能な銀ナノ粒子インクのデバイス応用技術」
- 「紙抄きでつくる紙の透明導電膜」
- 「フォトリソングプロセスを用いた導電性銅ナノインクの焼結と各種基材との密着性評価」

**新材料・ナノペースト**

- 「環状高分子を用いたエラストマーの応用について」
- 「LEDフリップチップ実装用材料「LEP」と実装技術」
- 「折り曲げ・打ち抜きに強い有機透明導電フィルムの開発」

**エネルギー・電池**

- 「有機薄膜太陽電池の現状と大阪市工研における材料開発」
- 「金属化合物ナノ粒子の合成と全固体リチウム二次電池への応用」
- 「エネルギーハーベスト:排熱パイプに密着装着可能なフレキシブル熱発電モジュール」

**基板・めっき**

- 「高密度有機配線基板 Advanced Package X (APX)の開発」
- 「多孔性電解皮膜の形成方法」
- 「微小流路型反応器とフローセル型 EQCM を用いた銅めっき中添加剤作用の定量化」

**装置技術**

- 「PE開発支援用コンパクトマルチプリンタ「Smart Labo-III」」
- 「新たな展開を見せるVPSリフロー方式」
- 「スラッド構造太陽電池接合技術」

- (株)デンソー
- (株)日立製作所 保田雄亮 氏
- (地独)大阪市立工業研究所 上利泰幸 氏

- オリンパス(株) 竹本 良章 氏
- (独)産業技術総合研究所 菊地克弥 氏
- 三菱化学(株) 池本 慎 杉山雅哉 氏

- 大日本印刷(株) 笹岡賢司 氏
- (株)デンソー 野本 薫 氏
- 福岡大学 加藤義尚 氏

- (独)産業技術総合研究所 高木秀樹 氏
- 東京大学 工学系研究科 Ying-Hui Wang 氏
- (株)日立製作所 山口拓人 氏

- オムロン(株) 酒井隆介 氏
- 東レエンジニアリング(株) 佐々本裕方 氏
- 東芝機械(株) 篠原秀敏 氏

- 山形大学 関根 智仁 氏
- 大阪大学 古賀 大尚 氏
- 石原薬品(株) 三田 倫広 氏

- アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株) 井上 勝成 氏
- デクセリアルズ(株) 石神 明 氏
- 長岡産業株式会社

- (地独)大阪市立工業研究所 松元深 氏
- 大阪府立大 辰巳砂研究室 麻生圭吾 氏
- (株)Eサーモジェンテック 大畑 恵一 氏

- 京セラ SLC テクノロジー(株) 梅本 孝行 氏
- 奥野製薬工業株式会社 原 健二 氏

- (株)コムラテック 坂本 剛 氏
- テクノアルファ(株) 大下 貴久 氏
- 東レエンジニアリング(株) 熱田直行 氏

# 関西ワークショップ2013



ナイトセッション



ナイトセッション全員写真



展望レセプション



モーニングセッション



講演会



ポスターセッション

## 参加費

●前泊2日間コース 35,000円 (7/10 締切)

夕暮れ展望レセプションパーティー \* ナイトセッション  
 宿泊費 \* 2日目ワークショップ参加費  
 (朝食、昼食費は含まれません)

●日帰り1日コース 19,800円 2日目ワークショップ参加費のみ  
 (朝食、昼食費は含まれません)

\*開催10日前まで受け付けますがトータル100名になり次第締め切らせて頂きます。  
 \*上記は会員、協賛団体会員価格となります。非会員の方は+10,000円の加算額となります。  
 \*発表テーマは仮題とします。講師、内容は変更になる場合があります。また、ご希望のセッションが  
 選定されない場合もありますので予めご了承ください。

## 予定

### 7/18 (木)

15:00~18:00 チェックイン (自由時間)  
 18:00~20:00 レセプション (夕暮れ展望レストラン 立食パーティー)  
 20:00~21:00 ナイトセッション1部 (講師5名のショート講演)  
 21:00~22:00 ナイトセッション2部 (各講師毎のグループへ分かれて討議)  
 22:00~ ナイトセッション3部 (各講師5部屋へ移動 自由集合)

### 7/19 (金)

8:00~ 8:45 モーニングセッション  
 8:45~ 9:00 オリエンテーション (2日目日帰りコースの参加)  
 9:00~10:00 ポスター アブストラクト トーク  
 10:00~11:00 講演会 第1部  
 11:00~12:00 講演会 第2部  
 12:00~13:45 昼休憩 (自由時間 13:00からプラネタリウム有料鑑賞可)  
 13:45~17:45 ポスターセッション  
 17:45~18:00 閉会

\*湖西線堅田駅(京都から19分)より送迎有・・・ 7月18日 14:35、16:35 7月19日 8:30 終了時18:15 堅田駅行  
 琵琶湖線守山駅 近江バス 守山駅発・・・ 8:30・・・14:45 15:45 16:45 17:46・・・  
 ラフォーレ 発・・・ 18:20・・・

主催 エレクトロニクス実装学会 関西支部

お問い合わせは Tel・Fax 06-6879-4598 E-mail:kansai@jiep.or.jp

協賛予定(交渉予定) 社団法人日本ロボット工業会 (JARA)、社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)、表面技術協会、  
 日本機械学会、溶接学会マイクロ接合研究委員会、日本材料学会、日本信頼性学会、日本金属学会、日本接着学会

FAX (06-6879-4598)

## 関西 WS2013 参加 申込書 (開催 2013年7月18, 19日)

参加コース 宿泊2日間コース・日帰り1日コース  
 氏名 (フリガナ)  
 勤務先  
 所属 (役職)  
 住所 〒  
 TEL/FAX  
 E-mail

●希望ナイトセッション (A~E) 講師名  
 (宿泊2日間コースの場合のみ)

正会員 (会員番号) )  
 賛助会員 (会員番号) )  
 協賛団体 (会員番号) )  
 団体名 \_\_\_\_\_  
 一般  
 学生一般